

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 3 部門第 3 区分
 【発行日】平成 18 年 3 月 16 日 (2006.3.16)

【公開番号】特開 2000-290628 (P2000-290628A)
 【公開日】平成 12 年 10 月 17 日 (2000.10.17)
 【出願番号】特願 平 11-103730

【国際特許分類】

C 0 9 J 163/00 (2006.01)
B 3 2 B 7/12 (2006.01)
B 3 2 B 27/00 (2006.01)
C 0 9 J 201/00 (2006.01)
H 0 5 K 3/38 (2006.01)

【F I】

C 0 9 J 163/00
 B 3 2 B 7/12
 B 3 2 B 27/00 D
 C 0 9 J 201/00
 H 0 5 K 3/38 E

【手続補正書】

【提出日】平成 18 年 1 月 18 日 (2006.1.18)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 2 0

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 2 0】

本発明による回路基板用接着剤組成物は、樹脂フィルム又は金属箔など表面上に塗布可能な性状（例えば、ペースト状、溶液状、分散液状）であるか、又は塗布可能な形状にすることのできる性状で提供される。

接着剤組成物の溶媒としては通常の有機溶媒、例えば、酢酸エチル、酢酸ブチル、塩化メチレン、クロロホルム、ベンゼン、キシレン、トルエン、アセトン又はメチルエチルケトン等を用いることができる。

前記接着剤組成物と金属箔との貼合方法としては、樹脂フィルム上に塗布した後に金属箔と貼合する方法、金属箔に塗布した後にフィルムと貼合する方法、剥離性を示すフィルムに接着剤組成物を塗布した後に樹脂フィルムと貼合し、樹脂フィルムに転写してから金属箔と貼合する方法がある。